

1/25

车规级第三代半导体 整合测试与应用(苏州)研讨会

2024
年度首映

电动车、快充带动第三代半导体碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)国际市场快速发展趋势、储能设备及高效能控制机台，需要更多强韧的运算芯片与电源管理IC功率组件，专注为高精度、高稳定度、高速测试、低单位IC测试成本与强大工程经验支持能力是攸关 POWER IC 研发及OSAT 测试成功的关键能力。

筑波科技与美商泰瑞达携手推广Eagle Test System (ETS)设备系列。因应测试芯片机台需求逐年成长，泰瑞达提供高质量检验、快速精准，降低测试成本、提升产能的ETS设备，具有高功率(>3000V)、高电流(>100A)、耐高温、精准稳定之特色，筑波为客户开发整合测试方案，并设立台湾新竹、中国深圳半导体工程中心(EC)提供高质量的服务。

我们邀请您与筑波科技专业团队就相关议题和技术交流！
欢迎第三代半导体产业领域的厂商先进主管现场或在线报名参加。

时间	议题	讲师
PM 1:00~1:30	报到登记	
PM 1:30~1:40	Welcome 致欢迎词	Steve Hsu 许深福 筑波网络科技 董事长
PM 1:40~2:10	WBG Power IC Market Trend 第三代半导体市场趋势与机会	Fred Huang 黄博彦 筑波网络科技 半导体销售总监
PM 2:10~2:40	车规级芯片中的验证挑战与泰瑞达应对方案	Daniel Fan 范敏/Aaron Lin 林思博 泰瑞达 业务总监/市场产品专家
PM 2:40~3:10	SIC MOSFET KGD 测试整合方案	Alex Li 苏州星测半导体 CTO
PM 3:10~3:30	Break	
PM 3:30~4:00	车载功率模块测试解决方案	柳焱佳 苏州正齐半导体 技术总监
PM 4:00~4:50	展示参观交流 DCM/HPD FT 测试方案 GaN MOSFET CP 测试方案展示	
PM 4:50~5:00	Q&A	



• ETS-88
General Analog
Power Mgmt



• ETS-364
Mixed-Signal
And Power



活动日期: 2024年1月25日 (四) PM1:00 ~ PM5:00

现场活动 + 线上直播
活动地点: 筑波网络科技(苏州)有限公司
苏州市工业园区和顺路58号A幢303室

半导体方案 华南/华西地区: 黄总监 Fred: 18666826750 (微信: fred6337)

联络窗口: 0755-29351095 蔡小姐 / 0512-89188620 吴小姐

报名网址: https://register.acesolution.com.tw/20240125_CNWBGSemiconductor_Seminar



码上报名

